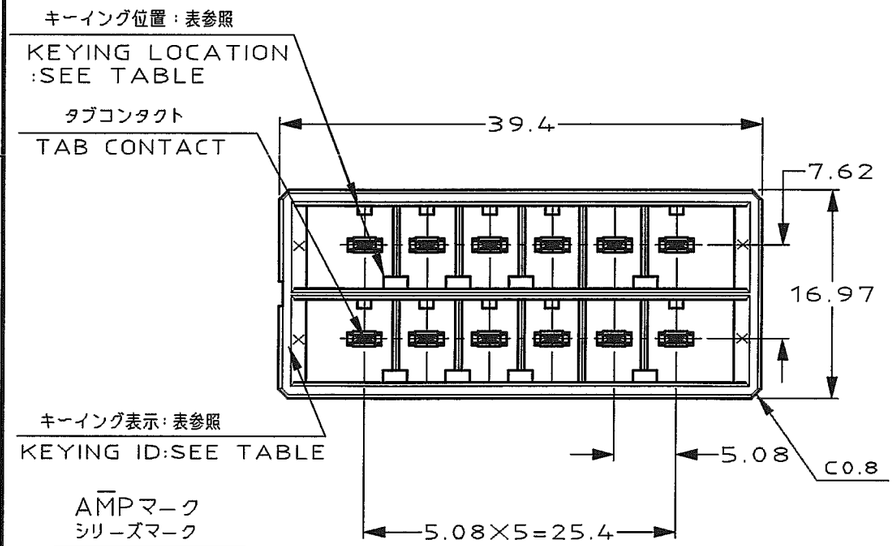
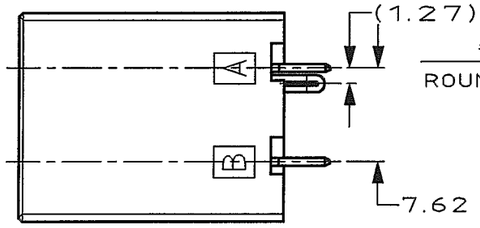
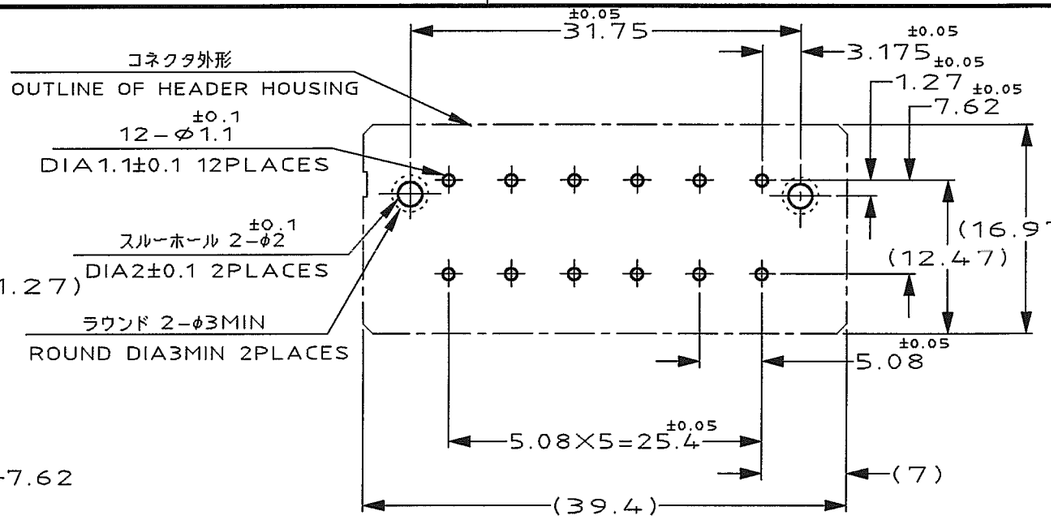
NUMBER 917658

3rd ANGLE PROJECTION

METRIC





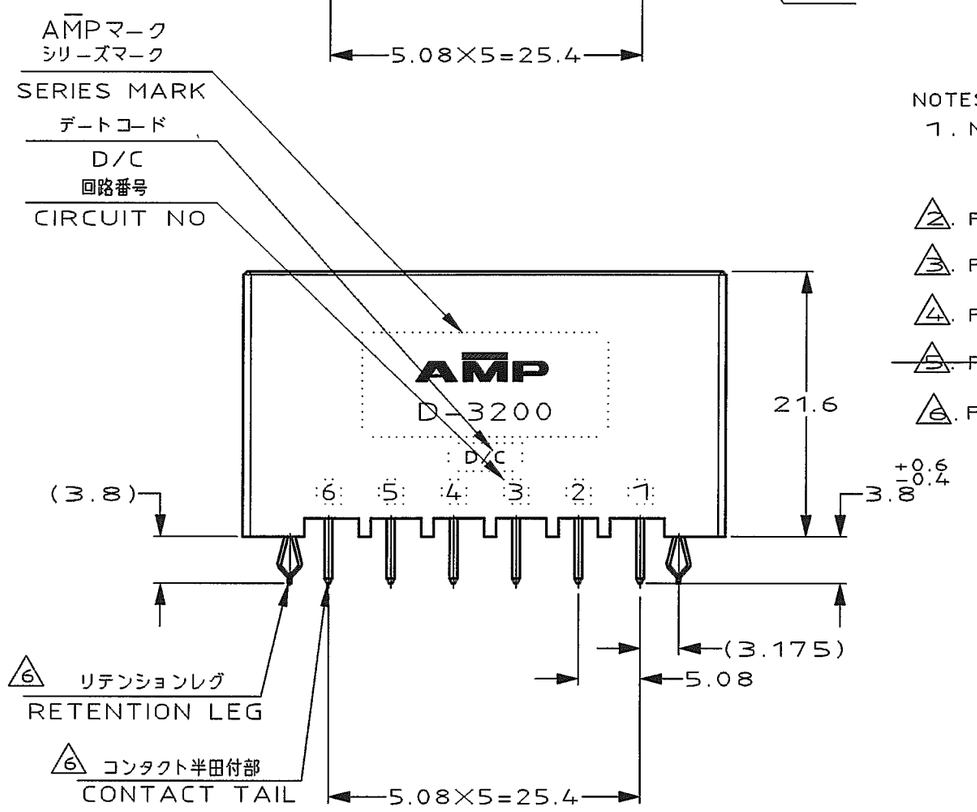


推奨基板取付け穴寸法

PC 基板厚：1.6±0.1
（非累積公差）
（コネクタ搭載面）

RECOMEND PC BOARD HOLE PATTERN

PC BOARD THICKNESS:1.6±0.1
(NOT ACCUMULATE TOLERANCE)
(CONNECTOR MOUNT SIDE)



NOTES

1. MATERIAL:HOUSING:GLASS FILED THERMO PLASTIC,POLYESTER(94V-0),COLOR:BLACK
CONTACT:COPPER ALLOY
RETENTION LEG:COPPER ALLOY
2. FINISH(CONTACT AREA):0.38μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
3. FINISH(CONTACT AREA):0.76μmMIN GOLD PLATING OVER Ni PLATING
4. FINISH(CONTACT AREA):2.0 μmMIN TIN PLATED OVER NICKEL
~~5. FINISH(RETENTION LEG): TIN-LEAD PLATED (CONTACT TAIL) OVER NICKEL~~
6. FINISH(RETENTION LEG): TIN PLATED
(CONTACT TAIL) OVER NICKEL

注記

1. 材料：ハウジング：ガラス入り熱可塑性
ポリエステル樹脂 (94V−0),色：黒
コンタクト：銅合金
リテンションレグ：銅合金
2. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：0.38μm MIN金めっき
3. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：0.76μm MIN金めっき
4. めっき：コンタクト：全面Ni下地
接触部：2.0 μm MINスズめっき
~~5. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部
：ニッケル下地の上に半田めっき~~
6. めっき：リテンションレグとコンタクト半田付部
：ニッケル下地の上にスズめっき

	KEYING LOCATION	A ROW KEYING	B ROW KEYING	FINISH	製品番号 PART NO.
A ROW / B ROW		X	Y	6 4	3-917658-5
				6 3	3-917658-3
				6 2	3-917658-2
A ROW / B ROW		Y	Y	6 4	2-917658-5
				6 3	2-917658-3
				6 2	2-917658-2
A ROW / B ROW		X	X	6 4	1-917658-5
				6 3	1-917658-3
				6 2	1-917658-2

TE Connectivity

LTR	REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
C1	REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11

WIRE RANGE mm²(AWG −)	INSULATION DIA − mmφ
MATERIAL SEE NOTE 注記参照	FINISH SEE NOTE 注記参照
DR. 24/APR/'95 K.IKEDA	DE. 24/APR/'95 K.IKEDA
CHK. 24/APR/'95 S.MANABE	APP. 24/APR/'95 S.MANABE

NAME ダイナミック D-3200 垂直タイプ 12 極
ヘッダーアセンブリー
DYNAMIC D-3200 12 POS.V-HDR ASS'Y

一般公差 (GENERAL TOLERANCE)
10以下 ±0.3
10を超え 30以下 ±0.4
30を超え100以下 ±0.45
角度 ±3°

SIZE A3 | LOC J | NUMBER C-917658
SCALE 2-1 | REV. C1 | SHEET 1 OF 1

PRINT DIST

DIMENSIONS IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE PRINT